

전자회로 소재가 한자리에

국내 전자회로 소재 및 장비 기업들이 한자리에 모였다.

<2010 국제전자회로산업전>이 2010년 4월27부터 29일까지 일산 킨텍스에서 개최됐다.



산업전에는 185사의 기업들이 참여해 전자회로 관련소재 및 장비에 대한 신기술을 선보이는 동시에 마케팅 공간으로 활용했다.

두산전자, 삼성SDI, LG이노텍, 이녹스 등은 PCB(Printed Circuit Board) 및 FPCB(Flexible Printed Circuit Board), LED(Light Emitting Diode) 회로소재에 대해 전시했고 한국케미텍, 서울화학연구소 등은 은과 구리 나노입자를 이용한 차폐 필름과 잉크, 코팅제 등을 출품해 관람객들의 관심을 끌었다.

특히, 서울화학연구소가 UV(자외선) 및 열경화를 이용한 회로보호잉크를 선보여 주목을 받았다.

이밖에 MRC는 PI(Poly Imide)필름을 대체할 수 있는 Kuraray의 LCP(Liquid Crystal Polymer)필름을 국내에 처음 공개하기도 했다.

전시 관계자는 “LCP는 EP(Engineering Plastic)로서 소켓 등 고강도, 고내열 부품으로만 사용되었다”면서 “LCP를 필름형태로 개발함으로써 비할로겐과 난연성 문제를 동시에 해결해야 하는 PI필름과 경쟁할 수 있을 것으로 예상된다”고 전망했다. <이명주 기자>

<화학저널 2010/04/30>